

整理番号 72310262

発送番号 420133

発送日 平成14年12月17日

1 / 4

拒絶理由通知書

| | |
|----------|-----------------|
| 特許出願の番号 | 特願2001-013869 |
| 起案日 | 平成14年12月 6日 |
| 特許庁審査官 | 守安 太郎 9347 4R00 |
| 特許出願人代理人 | 開口 宗昭 様 |
| 適用条文 | 第29条第2項、第29条の2 |

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公告又は出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時に於いて、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

(1) 上記理由1について

< 請 求 項 > 1

< 引用文献等番号 > 1-3

< 備 考 >

例えば引用文献2 (段落【0018】及び第1図を特に参照) 及び引用文献3 (第2頁左上欄第17行乃至末行を特に参照) に記載されたように、半導体チップの電極とリードフレームの電極端子との間を電氣的に接続する接続導体の表面を粗面化することにより、該接続導体と封止樹脂との密着性を向上させることは、当該技術分野において周知の技術と認められる。

したがって、引用文献1（段落【0005】及び第1図を特に参照）に記載された発明に上記周知の技術を適用し、引用文献1に記載された発明の接続導体（接触片P）の表面を単に粗面化することにより、この出願の請求項1に係る発明をなすことは、当業者であれば容易に相当し得た程度の事項と認められる。

< 請求項 > 3, 6, 8, 14, 17, 18

< 参考文献等番号 > 1-3

< 備考 >

接続導体の接続部分に接合材を部分メッキすることは、周知の技術と認められる。

したがって、引用文献1に記載された発明に、上記周知の技術をさらに適用することにより、この出願の出願の請求項3、6、8、14、17及び18に係る各発明をなすことに何ら困難性を認めることができない。

< 請求項 > 4, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 22

< 参考文献等番号 > 1-3

< 備考 >

板状部材の折り曲げを容易にするために、該板状部材の折り曲げ部分に溝を設けることは、周知の技術と認められる。

また、半田のはみ出しを防止するために、半田付け部分の近傍に凹部等のダムを設けることも、周知の技術と認められる。

したがって、引用文献1に記載された発明に、上記各周知の技術をさらに適用することにより、この出願の出願の請求項4、10、12、13、15、19、21及び22に係る各発明をなすことに何ら困難性を認めることができない。

< 請求項 > 5, 11, 20

< 参考文献等番号 > 1-4

< 備考 >

例えば引用文献4（第5頁右上欄第3行乃至第9行及び第5図を特に参照）に記載されたように、リードフレームに嵌合する爪部を接続導体に設けることは、当該技術分野において周知の技術と認められる。

したがって、引用文献1に記載された発明に、この周知の技術を単に適用することにより、この出願の請求項5に係る発明をなすことは、当業者であれば容易に想到し得た程度の事項と認められる。

また、引用文献1に記載された発明に上記各周知の技術をさらに適用することにより、この出願の請求項11及び20に係る発明をなすことに何ら困難性を認めることができない。

この出願の請求項５に係る発明と特願２０００－１５６７０８号の願書に最初に添付された明細書及び図面（引用文献５の段落【００１５】及び第１図を参照）に記載された発明（以下、「引用発明５」という。）とを対比すると、引用発明５の「コネクタ爪（１８）」は、この出願の請求項５に係る発明の「爪部」に相当し、両者は同一と認められる。

引用文献等一覽

1. 特開平10-004166号公報
2. 特開平05-166871号公報
3. 特開平03-151648号公報
4. 特開平02-121356号公報
5. 特願2000-156708号 (特開2001-339028号)

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

先行技術文献調査結果の記録

| 調査した技術分野 | I P C 第 7 版 | H O 1 L 2 3 / 4 8 |
|----------|-------------|-------------------|
| | | H O 1 L 2 3 / 5 0 |
| | | H O 1 L 2 1 / 5 6 |
| | | H O 1 L 2 1 / 6 0 |

· 参考文献

1. 実開昭62-036550号公報
2. 実開平04-015248号公報
3. 特開平06-085133号公報
4. 特開平07-326698号公報
5. 特開平11-150286号公報
6. 特開2000-183249号公報

この先行技術文献調査の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

発送番号 420133

発送日 平成14年12月17日

4 / 4

この拒絶理由通知の内容に関する問い合わせ先
審査第三部電子素材加工 審査官 守安 太郎
電話 03-3581-1101 内線3470